



## 高性能的在线双轨 操作3D检测

S3088 DT是一款在许多方面都格外优异的预配置双轨操作光学3D检测系统，它具有令人叹服的成本效益、速度和技术性能。其联网设计旨在与MES(制造企业生产过程执行系统)、生产线控制和其他机器进行全面的信息交流。凭借配备精良的S3088 DT，电子制造厂引入全自动化进程和先进的处理概念，从而快速且可靠地检测电子组件。

S3088 DT能够快速准确地检测出印刷电路板上的焊点和组件。直角分辨率为 10 μm/像素，即使是03015结构元件也能可靠地进行检测。3D AOI系统的一个突出特点是图像大小为 50 mm 乘 50 mm。检测速度最高可达 65 cm<sup>2</sup>/s。操作软件提供了许多极为实用的辅助工具，从而以质量为本进行进程控制。能够迅速且直观地创建检测程序。

系统灵活适应不同轨道宽度。如有必要，也可单轨使用。S3088 DT 的设计符合人体工程学且节省空间。集成在外壳门中的显示器体现了，即使在高生产密度下也要尽可能留出宽敞通行空间的要求。

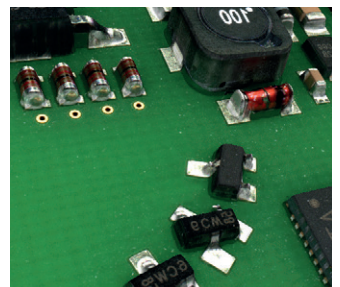
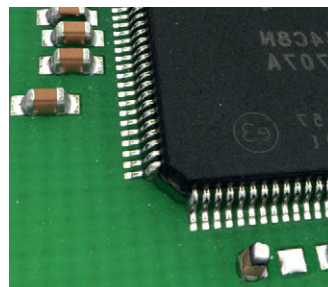
高性能3D AOI技术

可作为双轨或单轨系统灵活使用

集成式显示器，优化空间

智能的进程控制工具

完全兼容最先进的工业4.0接口



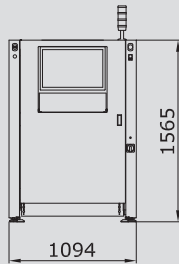
最大限度概览全貌的 3D 图像，并可通过 Viscom 的 360View 扩展软件自由选择视角

3D AOI

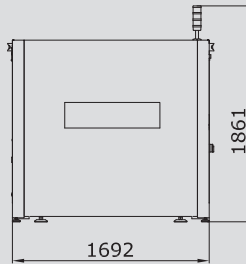
# 技术数据



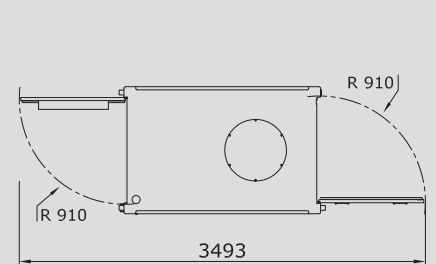
前视图



侧视图



俯视图



单位: mm

		S3088 DT
检测领域	3D AOI	焊锡连接点、元件组装、焊锡印刷
相机技术*	3D相机技术	
	Z分辨率	0.5 μm
	Z测量范围	可达30 mm
	斜角相机	
	百万像素相机数量	8
	直角相机	
软件	分辨率	10 μm
	图像大小	50 mm x 50 mm
	用户界面	Viscom EasyPro/vVision可选
	统计进程控制	Viscom SPC, 开放式界面 (选项)
	验证维修站	Viscom HARAN/vVerify可选
系统计算机	远程分析判断	Viscom SRC (软件远程控制) (选项)
	编程站	Viscom PST34 (选项)
电路板传送	操作系统	Windows®
	处理器	Intel® Core™ i7
检测速度	传送模式	双轨传输
	印刷电路板的大小 (长 x 宽)	450 mm x 350 mm, 最小宽度 70 mm
	传送高度	900 - 950 mm ± 20 mm
	宽度调整	自动**
	印刷电路板夹板方式	气动
	上侧净空尺寸 (最大值)	50 mm
其他系统数据	下方净空尺寸	40 mm**
	检测速度	最高可达65 cm²/s
其他系统数据	轴运动/定位单元	同步线性马达
	接口	SMEMA (其他接口根据需求提供)
	电源要求	400V (其他电压根据需求提供), 3P/N/PE, 8 A, 最大压缩空气 10 bar (工作压力 4 - 6 bar)
	设备的大小	1094 mm x 1565 mm x 1692 mm (宽 x 高 x 长)
	重量	1400 公斤

\*标准配置, 其他相机根据需求提供。

\*\* 根据需求提供宽度调整或上下净空尺寸选项。